

Transfer Molding System

Model YPM1250-EPQ



Transfer molding system for 2.5D/3DIC/Chiplet products



2.5D/3DIC/Chiplet产品的注塑成形设备

- 适用于最大基板尺寸150mm（6inch）的大型模压机
- 适用于基板搬运用载板（Carrier）
- 可通过设计Edge gate抑制溢胶问题
- 可通过大容量Flow cavity和 R.F.C.P.技术，实现充填难度高的大尺寸芯片的MUF成形
- 可通过Double Plunger，实现大面积封装的树脂量需求
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	YPM1250-EPQ			
框架·基板类型		—	基板			
基板尺寸		mm	□60—□150/100×300 (Max.)			
Boat carrier尺寸	长度	mm	310—390			
	宽度	mm	160—200			
树脂	径	mm	φ 14, 16, 18, 20			
	长度	mm	14.3—35.0			
机械时间		sec	Approximately 108			
外形尺寸	模组数量	module	1	2	3	4
	宽度	mm	5,240	6,240	7,240	8,240
	纵深	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
	高度	mm	2,685	2,685	2,685	2,685
重量		ton	15.0	23.0	31.0	40.0
每模成形基板数量	基板尺寸 □60—□90	workpiece	6			
	基板尺寸 □85—□150	workpiece	4			
进料盒空间		mm	870			
出料盒空间（插片式收料方式）		mm	870			
合模压力		kN/(tf)	294.0—2,450.0/30.0—250.0			
注塑压力		kN/(tf)	9.8—98.0/1.0—10.0 (2 step pressure setting)			
品种切换方式		—	采用KIT更换方式			
可以安装的模具		—	YPM1250-EPQ租用模具			
使用分离膜的宽度		mm	100—530			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要有可能变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标）， 是TOWA株式会社的商标或注册商标。
R.F.C.P.是TOWA株式会社在中国的注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation